

Generelle Empfehlung: Die beiden Lötflächen eines Klemmpoles auf der Platine sollten elektrisch miteinander verbunden werden

## SMD-Leiterplattenklemme Nano mit Steckkontakten und Kontaktöffnungsfunktion

2-polig - 46.142.1001.50

Direktes Stecken von eindrätigen Leitern

Kontaktöffnungsfunktion - zur Entnahme bereits eingesteckter Leiter

Montage- und Verdrahtungsposition: Leiterplatte oberseitig

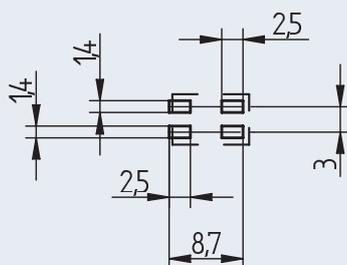
Automatengerechte "Tape-and-Reel" Verpackung

Befestigung: Bleifreie Reflow-Lötung nach DIN EN 61076-1, Abschnitt 6

Material: Gehäuse: PPA, weiß  
 Kontaktwerkstoff: CuNi  
 Kontaktoberfläche: feuerverzinkt

Zur Betätigung der Kontaktöffnungsfunktion, empfehlen wir den Einsatz unseres Werkzeugs 46.141.U801.89

Empfohlene Maße für die Lötflächen



### Daten zur Verpackung 46.142.1001.50

|   |                    |
|---|--------------------|
| Gewicht SMD-Klemme                            | 0.19 g             |
| Anzahl pro Spule                              | 4.050              |
| Durchmesser der Spule                         | 15"                |
| Gewicht pro Spule                             | 1.249 kg           |
| Anzahl an Spulen pro Karton                   | 18                 |
| Anzahl an SMD-Leiterplattenklemmen pro Karton | 72.900             |
| Gewicht pro Karton                            | 22.48 kg           |
| Gewicht Karton                                | 1.26 kg            |
| Abmessungen Karton (LxBxH)                    | 400 x 355 x 365 mm |
| Gesamtgewicht                                 | 23.74 kg           |



### Zubehör:

SMD Nano-Flex-B2B-Verbinder. Zur Verbindung von Leiterplatten. Die Verbinder sind in 21 mm Länge erhältlich.



46.141.U701.50



46.142.U701.50



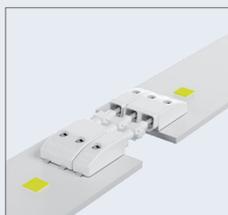
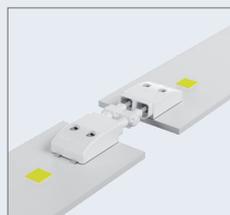
46.143.U701.50

### Werkzeug zur Kontaktöffnung

Zur Entnahme bereits eingesteckter Leiter



46.141.U801.89



| Anschlussdaten             |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Anschluss technik          | Steckkontakt                          |
| Eindrähtige Leiter         | 0.2 - 0.5 mm <sup>2</sup> , AWG 24-20 |
| Abisolierlänge             | 7 ±0.5 mm                             |
| Leitereinführung           | 0                                     |
| Leiterlösefunktion mittels | Werkzeug zur Kontaktöffnung           |

| Auszugskraft nach DN 60999-1 |           |
|------------------------------|-----------|
| 0.2 mm <sup>2</sup>          | min. 10 N |
| 0.34 mm <sup>2</sup>         | min. 15 N |
| 0.5 mm <sup>2</sup>          | min. 20 N |
| 0.75 mm <sup>2</sup>         | min. 30 N |
| Einsteckkraft                | max. 10 N |

| Geometrische Daten               |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Rastermaß                        | 3 mm / 0.12 inch   |
| Breite                           | 6 mm / 0.24 inch   |
| Höhe                             | 2.7 mm / 0.11 inch |
| Tiefe                            | 9.3 mm / 0.37 inch |
| Spulendurchmesser Gurtverpackung | 330 mm (13")       |
| Gurtbreite                       | 16 mm              |
| Pitchabstand                     | 8 mm               |
| Verpackungseinheit Tape-and-Reel | 2.800              |
| Verpackungseinheit Karton        | 50.400 (18 Spulen) |

| Werkstoffdaten                    |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Isolierstoffgruppe                | I             |
| Isolierwerkstoff                  | PPA, weiß     |
| PTI                               | 600           |
| Entflammbarkeitsklasse nach UL 94 | V0            |
| Kontaktwerkstoff                  | CuNi          |
| Kontaktfläche                     | feuerverzinkt |

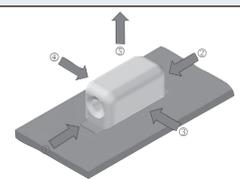
| Mechanische Daten |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Montageposition   | Leiterplatte oberseitig |
| Befestigungsart   | Bleifreies Reflow-Löten |

| Temperaturbedingungen                      |                     |
|--|---------------------|
| Grenztemperaturbereich                     | -40 °C bis + 150 °C |
| Umgebungstemperatur                        | -40 °C bis + 125 °C |
| T-Klassifizierung nach IEC 60998-1 Abs. 12 | 120°                |

| Bemessungsdaten gemäß IEC / EN 60947-7-4 (IEC/EN 60664-1) |        |
|---|--------|
| Bemessungsspannung (III / 3)                              | 63 V   |
| Bemessungsstoßspannung (III / 3)                          | 2.5 kV |
| Bemessungsspannung (III / 2)                              | 160 V  |
| Bemessungsstoßspannung (III / 2)                          | 2.5 kV |
| Bemessungsspannung (II / 2)                               | 320 V  |
| Bemessungsstoßspannung (II / 2)                           | 2.5 kV |
| Bemessungsstrom   | 3 A    |

| Bemessungsdaten gemäß UL 1977 |              |
|-------------------------------|--------------|
| Bemessungsspannung UL 1977    | 320 VAC / DC |
| Bemessungsstrom UL 1977       | 3 A          |

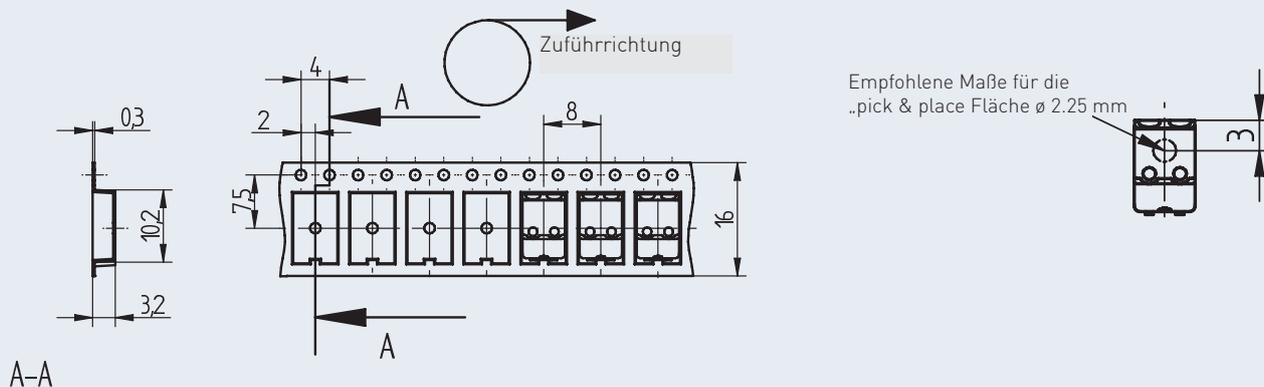
| Länderspezifische Zulassungen Zertifikate |                          |
|---|--------------------------|
| VDE ENEC                                  | EN 60947                 |
| UL  | cURus, File No. E-365006 |

| Scherkräfte nach IEC 62137-1-2: 2007.   |  |
|---|--|
| Bei diesen Werten handelt es sich um Maximumwerte, die nur für eine kurzzeitige Belastung gelten, nicht für Dauerbelastung. |  |
| Richtung 1 + 2 Scherkraft längs   | 60   |
| Richtung 3 + 4 Scherkraft quer  | 25   |
| Richtung 5 Abzugskraft  | 25   |

## Hinweise zur Verarbeitung

Geeignet für bleifreie Reflow-Lötprofile in Anlehnung an DIN EN 61760-1 bzw. DIN EN 60068-2-58 bis zu einer Peak-Temperatur von max. 260 °C. Aufgrund von unterschiedlichen anwendungsspezifischen Einflussgrößen (Bauteilanordnung und -ausrichtung, Lötanlage, Lötpaste) wird empfohlen, mittels Testläufen ein geeignetes Profil unter Fertigungsbedingungen zu ermitteln.

Abhängig vom SMD-Prozess und den Lötparametern kann eine leichte Verfärbung auftreten, welche jedoch die technische Funktionsweis nicht beeinflusst.



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Lagerdauer                    | Lötbarkeit bei Lagerung zwischen -5°C und +40°C bei 10 - 60 %rH bis zu 6 Monaten. Bei Verarbeitung nach mehr als 6 Monaten sollte die Lötbarkeit gemäß J-STD-002D oder DIN EN 60068-2-58:2016 überprüft werden. |
| max. zulässige Reflowvorgänge | 3   |
| Lötprofil                     | <p><b>Reflow-Profil (bleifreies Löten):</b></p>   |
| Lötbarkeit                    | Lötbarkeit der Bauteile ist durch Benetzungstest gemäß J-STD-002D geprüft   |
| Montageverfahren              | SMD, nach Zeichnung   |
| Materialstärke SMD-Schablone  | 100 - 150 µm (Empfehlung BJB 150)   |